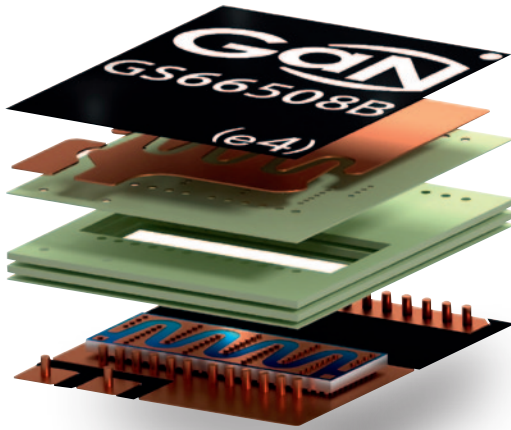


INHALT

Juli 2016



1255

Leistungstransistoren in sehr kompakten GaNPX-Packages: ECP (Embedded Component Technology) ist die Antwort auf die notwendige, zunehmende Miniaturisierung für immer leistungsfähigere Anwendungen und Produkte



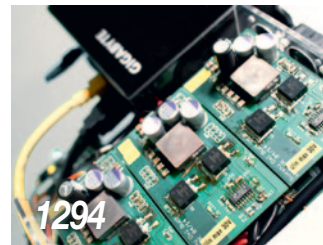
1253

Technologien mit atomarer Präzision für die übernächste Chip-Generation



1263

Eventuell ab 2017 weltweit erste faltbare Smartphones mit biegsamem OLED-Display



1294

Fußballbegeisterung, Pioniergeist und technisches Know-how für einen Roboter

EDITORIAL

Lötparameter und zuverlässige Lötverbindungen – (k)ein Glücksspiel?! 1225

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 1229
 Neue Normen 1245
 Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 1246

BAUELEMENTE

Technologien mit atomarer Präzision für die übernächste Chip-Generation 1253
 Leistungstransistoren in sehr kompakten GaNPX-Packages 1255

BAUELEMENTE

OLED-Lighting – Anlaufprobleme einer Technologie 1257
 Optische Sensoren und Fotomikrosensoren 1259

DESIGN

Biegsame Falt-Handys ab 2017? 1263
 Cadence präsentiert neues PSpice Internetportal 1265
 Lego 2.0 – smarte Legosteine ermöglichen Web-Verbindung 1266
 Parallele mechatronische Entwicklung verkürzt Time-to-Market von Nutzfahrzeugen 1269

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit): ‚Die digitale Welt gestalten‘ – der ZVEI Jahreskongress 1278



ventec

INTERNATIONAL GROUP

騰輝電子



1322

Spezielles Verfahren für zuverlässiges und porenfreies Reflow-Löten von CMOS-Sensoren in der Kamerafertigung

LEITERPLATTENTECHNIK

- | | |
|--|------|
| Restrukturierung beschleunigt Wachstum in Europa | 1287 |
| Einfachere und präzisere Leiterplattenanalysen zum schnelleren Erstellen von Angeboten | 1289 |
| Hochpräzise Leiterplattenbearbeitung | 1291 |
| Fußballbegeisterung, Pioniergeist und technisches Know-how | 1294 |
| Die indische Leiterplattenindustrie | 1297 |

BAUGRUPPEN & SYSTEME

- | | |
|--|------|
| Passgenaue Schutzlackierung für sensible Elektronik | 1317 |
| Zuverlässiges und Void-freies Reflow-Löten von CMOS-Sensoren in der Kamerafertigung | 1322 |
| Validierung von Prozessen – im Fokus des Europäischen Elektroniktechnologie-Kollegs 2016 | 1324 |
| Kunden- und Lieferanten im Mittelpunkt – Partner des Erfolgs | 1331 |
| Neuer Single-Board Computer Raspberry Pi 3 mit größerer Leistung | 1336 |

ANALYTIK & TEST

- | | |
|--|------|
| Technologietag Baugruppentest 2016 – tiefe Einblicke und zukunftsweisende Technologien | 1346 |
| Dienstleistungsangebot um Flying-Probe-Tests erweitert | 1349 |
| Präzisere und intelligenterere Testsysteme | 1350 |

PLUS 7/2016 | 1227

Höchste Qualitätsstandards für Aerospace & Defense durch AS9100 Rev C Zertifizierung



Leiterplattenhersteller aus der Luft- & Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100 Rev C-akkreditierte Lieferkette für hochzuverlässige Basismaterialien und Prepregs. Von der Herstellung bis zur Lieferung ist unser gesamtes qualitativ hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, FR4 und unserer 'tec-speed' Serie von High-Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt. Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact@ventec-europe.com

T: Follow @VentecLaminates

www.ventec laminates.com



Gute Branchenstimmung in der deutschen Photovoltaik-Industrie bei Herstellern von Komponenten, Maschinen und Anlagen

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Selektive Löttechnik – präzises Temperatur-Profilung mit neuentwickeltem System	1356
Altern, Sprödigkeit und Elastizität von Lötstellen	1362
Patente	1364

FORUM

Gute Branchenstimmung in der deutschen Photovoltaik-Industrie	1366
Statistiken, Benchmarks und Marktanalysen	1368
Microelectronics Saxony – Kontakte, wirksam und sicher	1373
Kolumne: Formsache oder die ‚Quadratur des Kreises‘	1381
PLUS-Firmenverzeichnis	1383
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	1411
Inserentenindex	1413
Mediadaten	1414
Impressum	1415
Produkt des Monats	1416

Titelbild

Das neue PCB Release 17.2 von Cadence für OrCAD und Allegro unterstützt jetzt viele Designregeln speziell für starrflexible Leiterplatten.

Weitere Informationen:
www.FlowCAD.de

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente Distribution e.V.
Tel. +49 8563 9788908
w.ziefhuss@fbdi.de, www.fbdi.de

1261



Fachverband Elektronik-Design e.V.
Tel. +49 30 8349059
info@fed.de, www.fed.de

1273



EIPC – Der Europäische Elektronik-Verband
Tel. +31 43 344087-2
www.eipc.org

1282



Fachverband Electronic Components and Systems
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

1312



Fachverband PCB and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY – Deutschland e.V.
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

1338



Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.
Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1351



DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.
Tel. +49 211 1591-0
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

1365